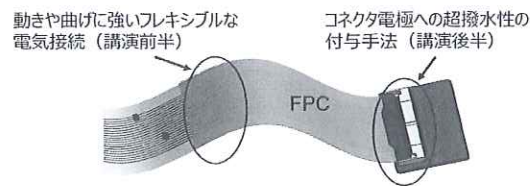


フレキシブルハイブリッドエレクトロニクスに向けた 電気接続技術および撥水加工技術

日本航空電子工業㈱ 中島伸一郎

近年、モノの状態や変化をセンサ搭載の機器によってデータ化し、その解析結果をフィードバックさせることにより価値を創出しようとする IoT に関する動きが活発化している。大量のセンサを利用する社会では、使い捨てを可能とする安いセンサデバイスの需要も急増すると考えられ、それらのデバイスは様々な場所に取り付けられるべく薄く、折り曲げ可能で、屋外環境などにも適用できる構成されることが望まれる。このような観点から、著者らは IoT 推進の鍵技術は、フレキシブルな電子デバイス開発、とりわけ電子デバイスのフレキシブル化と撥水性を保証する革新的な接続/実装技術であると考えている。本報告では、小型携帯機器内で広く用いられるプリント配線基板 (FPC) の周辺技術として、前半部分では FPC 端子の接続部に関して曲げや動きに強いフレキシブルな電気接続手法について述べる。後半部分では、FPC 端子を嵌合するコネクタ端子について、撥水性に優れる端子の製造手法について述べる (下図)。



本講演の概念図